**國家科學及技術委員會新聞稿**

**全球頂尖科研團隊、科技巨擘齊聚**

 **2023未來科技館盛大開幕**

日期：112年10月12日

發稿單位：產學及園區業務處

聯絡人：程稚茵科員

電話：2737-7232

E-mail：parker@nstc.gov.tw

由國科會與中央研究院、教育部、衛福部攜手打造，2023 台灣創新技術博覽會（TIE）-未來科技館，自今（12）日至 14 日三天在世貿一館盛大舉行。今年匯集台灣前瞻科研80隊未來科技獎獲獎團隊、12件TIE Award全球頂尖趨勢技術，及各部會代表科研成果近200件技術，並舉辦趨勢國際論壇，彰顯台灣科技對全球產業趨勢的關鍵影響力。

國科會藉由遴選海內外關鍵科技、強化鏈結台灣產業促進合作，並邀請超過20位各國產官學科技巨擘蒞臨分享大師觀點，並呼應生成式AI等科技熱度，規劃參觀者有感的「半導體」、「太空科技」與「精準健康」3大主題體驗區，跨部會傾力將未來科技館打造為國際品牌，推廣全民科普外更吸引全球頂尖人才來台落地、創造商機。

**吳政忠主委偕海內外專家 展望台灣領航未來科技發展**

開幕首日由指標半導體產業議題揭開序幕，邀請國內大廠瑞昱、聯發科，海外權威機構比利時微電子研究中心（imec）、意法半導體，及陽明交大、加州大學柏克萊分校教授等頂尖講者，暢談未來半導體科學突破和創新應用，別具指標意義。

吳政忠主委表示，生成式AI蓬勃發展帶動全球高科技產業大幅成長，台灣需持續布局全球維持原有競爭優勢。為此國科會提出「晶創台灣計畫」，以台灣半導體產業優勢，吸引全球IC相關人才來台研發落地，進而驅動全產業創新，也盼藉由今日論壇鏈結產官學領域，齊心展現科技和產業韌性，為台灣半導體創造更大價值。

**TIE Award Unveil 全球科研落地台灣**

除「半導體」讓台灣站在世界高峰外，「淨零排放」亦為全球趨勢，因此今年TIE Award擴大以雙主題向全球徵案，吸引29國新創報名角逐。其中半導體組由以色列 Chain Reaction 開發的加密演算高效晶片奪冠、第二名由台灣創鑫智慧開發的利基 AI 加速晶片奪下、第三名為加拿大 Blumind 開發新型AI神經網絡晶片及台灣學研團隊至達科技針對積體電路晶片設計提供實體設計平面規劃最佳化解決方案；而淨零組冠軍為美國Cryo Desalination首創利用液化天然氣降壓廢能進行海水淡化技術、第二名為日本Thermalytica研發新型超級隔熱材料、第三名為台灣學研團隊鴻躉開發環保太陽能面板回收方案。

為促進技術落地，國科會除依據技術特性展前媒合，也安排獲獎團隊於13日進行發表並與企業、創投代表一對一接洽，提升鏈結成效。

**展區、論壇活動精彩豐富 歡迎各界踴躍觀展**

未來科技館3日展期除首日論壇半導體論壇，13日「太空科技論壇」、14日「淨零科技論壇」將陸續登場。其中太空論壇首次邀請到JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）理事長 Yamakawa Hiroshi，及日本新創Space One總經理Takayuki Kawai分享在「新太空」時代下發展策略；而淨零科技論壇邀請到國際創投SOSV、台灣淨零科技方案推動小組，及國科會、永豐餘等產官學代表，盼為台灣永續發展找到最佳解方。

此外，13日「高通台灣研發合作計畫成果發表」，將共同見證國內4間頂尖大學與高通公司在通訊、人工智慧等合作研發的成果；14日「科技與運動的交會」更邀請到台灣蝶王王冠閎、拳擊女王陳念琴、亞洲貓王體操選手唐嘉鴻共同分享運動科技如何帶動體育產業轉型，陣容吸睛。

來不及報名活動聆聽也無妨，未來科技館10月12至14日豐富有趣的展區除了獲獎團隊現場說明技術成果，三大主題體驗區也透過互動式裝置讓科技淺顯易懂，是一次掌握趨勢技術、寓教於樂的絕佳機會，歡迎各界踴躍參與。

* 精彩展會活動不容錯過 歡迎踴躍報名 <https://reurl.cc/y6ekjM>
* 相關活動請見官網 <https://reurl.cc/GKbe2>Z